



<b>Title of Change:</b>	Capacity Expansion of Assembly and Test operations of Cebu former Fairchild SC70 package and JCET Jiang Yin SC70 package to ON Semiconductor Leshan, China and addition site of the backmetal to ON Niigata, Japan.				
<b>Proposed First Ship date:</b>	9 May 2019				
<b>Contact Information:</b>	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <Joan.Abigail.Enriquez@onsemi.com>				
<b>Samples:</b>	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.Samples@onsemi.com> Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change.				
<b>Type of Notification:</b>	<p>This is an Initial Product/Process Change Notification (IPC2N) sent to customers. IPC2Ns are typically issued 30 days prior to the issuance of the Final Change Notice (FPCN). An IPC2N is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan.</p> <p>The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPC2N notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact &lt;PCN.Support@onsemi.com&gt;</p>				
<b>Change Part Identification:</b>	Customer may receive the parts from ON Semiconductor Leshan, China from month of Apr 2019 onwards once FPCN expire. Parts from ON Semiconductor Leshan, China can be identified through product marking which follow ON Semiconductor marking format.				
<b>Change Category:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Wafer Fab Change <input checked="" type="checkbox"/> Assembly Change <input checked="" type="checkbox"/> Test Change <input type="checkbox"/> Other _____				
<b>Change Sub-Category(s):</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Manufacturing Site Addition <input checked="" type="checkbox"/> Material Change <input type="checkbox"/> Datasheet/Product Doc change <input type="checkbox"/> Manufacturing Site Transfer <input type="checkbox"/> Product specific change <input checked="" type="checkbox"/> Shipping/Packaging/Marking <input type="checkbox"/> Manufacturing Process Change <input type="checkbox"/> Other: _____				
<b>Sites Affected:</b>	ON Semiconductor Sites: ON Leshan, China (Assembly & Test Site) ON Cebu, Philippines (Assembly & Test Site)			External Foundry/Subcon Sites: JCET (Assembly & Test site)	
<b>Description and Purpose:</b>					
	<b>Before Change Description</b>		<b>After Change Description</b>		
Assembly & Test site	<b>ON Cebu, Philippines</b>	<b>JCET, China</b>	<b>ON Cebu, Philippines</b>	<b>JCET, China</b>	<b>ON Leshan, China</b>
LeadFrame	Ag Plated LF	Ag Plated LF	Ag Plated LF	Ag Plated LF	Cu Plated LF
Mold Compound	CK5000A	EDALE ELER-8-100HFE	CK5000A	EDALE ELER-8-100HFE	Henkel GR640 HV L1
Case outline	419AD	419AD	419AD	419AD	419B-02
BGBM Site	ON Bucheon, Korea	Phenitex, Japan	ON Bucheon, Korea	Phenitex, Japan	ON Niigata, Japan
Backmetal type	Ti Ni Ag Tin Backmetal	Gold backmetal	Ti Ni Ag Tin Backmetal	Gold backmetal	Gold backmetal
	<b>From</b>		<b>To</b>		
Product marking change	Ex-FCS Format		ON Semiconductor format		

**Qualification Plan:**

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated BV	1008 hours
HTGB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated Vgss	1008 hours
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hours
PC	J-STD-020 / JESD-A113	MSL 1 @260°C	
IOL + PC	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C ON/OFF = 2 min	15,000 cycles
TC + PC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cycles
H3TRB + PC	JESD22-A101	Ta=85°C, 85% RH, 80% max rated BV	1008 hours
uHAST + PC	JESD22-A118	Ta=130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hours
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

Estimated date for qualification completion: 4 January 2019

**List of Affected Parts:**

**Note:** Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
FDG311N	
FDG312P	
FDG315N	
FDG316P	
FDG327N	
FDG327NZ	
FDG328P	
FDG6301N	
FDG6303N	
FDG6304P	
FDG6306P	FDG316P, FDG328P, FDG6304P
FDG6308P	
FDG6316P	
FDG6317NZ	
FDG6318PZ	
FDG6320C	
FDG6321C	
FDG6322C	
FDG6332C	
FDG6335N	
2N7002DW	
2N7002DW_G	2N7002DW_G

Japanese translation of the notification starts here.  
通知の日本語訳はここから始まります。

*Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



## 初回製品 / プロセス変更通知

文書番号: IPCN22577X

発行日: 9 January 2019

変更件名:	セブ(旧フェアチャイルド)および JCET Kiang Yin で生産している SC70 パッケージの生産キャパシティー増強のため、オン・セミコンダクター楽山(中国)を組立ておよびテスト拠点に、またオン新潟(日本)をバックメタルの拠点に追加。																																																			
初回出荷予定日:	9 May 2019																																																			
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Joan.Abigail.Enriquez@onsemi.com> にお問い合わせください。																																																			
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。																																																			
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、通常、最終変更通知 (FPCN) の発行の 30 日前に発行されます。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら、<PCN.Support@onsemi.com> にお問い合わせください。																																																			
変更部品の識別:	お客様はオン・セミコンダクター楽山(中国)品を、FPCN が承認された場合は 2019 年 4 月から受け取ることができます。オン・セミコンダクター楽山(中国)品は、オン・セミコンダクターの表示フォーマットに従う製品表示により識別できます。																																																			
変更カテゴリ:	<input checked="" type="checkbox"/> ウェハファブの変更 <input checked="" type="checkbox"/> アセンブリの変更 <input checked="" type="checkbox"/> 試験の変更 <input type="checkbox"/> その他 _____																																																			
変更サブカテゴリ:	<input checked="" type="checkbox"/> 製造拠点の追加 <input checked="" type="checkbox"/> 材料の変更 <input type="checkbox"/> データシート/製品資料の変更 <input type="checkbox"/> 製造拠点の移転 <input type="checkbox"/> 製品仕様の変更 <input checked="" type="checkbox"/> 出荷/パッケージング/表記 <input type="checkbox"/> 製造プロセスの変更 <input type="checkbox"/> その他: _____																																																			
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: ON Leshan, China (Assembly & Test Site) ON Cebu, Philippines (Assembly & Test Site)		外部製造工場 / 下請業者拠点: JCET (組み立ておよびテスト拠点)																																																	
説明および目的:	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">組み立ておよびテスト拠点</th> <th colspan="2">変更前の表記</th> <th colspan="3">変更後の表記</th> </tr> <tr> <th>オンセブ(フィリピン)</th> <th>JCET(中国)</th> <th>オンセブ(フィリピン)</th> <th>JCET(中国)</th> <th>オン楽山(中国)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リードフレーム</td> <td>銀メッキリードフレーム</td> <td>銀メッキリードフレーム</td> <td>銀メッキリードフレーム</td> <td>銀メッキリードフレーム</td> <td>銅メッキリードフレーム</td> </tr> <tr> <td>モールドコンパウンド</td> <td>CK5000A</td> <td>EDALE ELER-8-100HFE</td> <td>CK5000A</td> <td>EDALE ELER-8-100HFE</td> <td>ハンゲル GR640 HV L1</td> </tr> <tr> <td>ケース外形</td> <td>419AD</td> <td>419AD</td> <td>419AD</td> <td>419AD</td> <td>419B-02</td> </tr> <tr> <td>BGBM 拠点</td> <td>オン富川(韓国)</td> <td>フェニテック(日本)</td> <td>オン富川(韓国)</td> <td>フェニテック(日本)</td> <td>オン新潟(日本)</td> </tr> <tr> <td>バックメタルの種類</td> <td>チタン、ニッケル、銀、スズのバックメタル</td> <td>金のバックメタル</td> <td>チタン、ニッケル、銀、スズのバックメタル</td> <td>金のバックメタル</td> <td>金のバックメタル</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>製品表示変更</td> <td>Ex-FCS フォーマット</td> <td>オン・セミコンダクター フォーマット</td> </tr> </tbody> </table>					組み立ておよびテスト拠点	変更前の表記		変更後の表記			オンセブ(フィリピン)	JCET(中国)	オンセブ(フィリピン)	JCET(中国)	オン楽山(中国)	リードフレーム	銀メッキリードフレーム	銀メッキリードフレーム	銀メッキリードフレーム	銀メッキリードフレーム	銅メッキリードフレーム	モールドコンパウンド	CK5000A	EDALE ELER-8-100HFE	CK5000A	EDALE ELER-8-100HFE	ハンゲル GR640 HV L1	ケース外形	419AD	419AD	419AD	419AD	419B-02	BGBM 拠点	オン富川(韓国)	フェニテック(日本)	オン富川(韓国)	フェニテック(日本)	オン新潟(日本)	バックメタルの種類	チタン、ニッケル、銀、スズのバックメタル	金のバックメタル	チタン、ニッケル、銀、スズのバックメタル	金のバックメタル	金のバックメタル		変更前	変更後	製品表示変更	Ex-FCS フォーマット	オン・セミコンダクター フォーマット
組み立ておよびテスト拠点	変更前の表記		変更後の表記																																																	
	オンセブ(フィリピン)	JCET(中国)	オンセブ(フィリピン)	JCET(中国)	オン楽山(中国)																																															
リードフレーム	銀メッキリードフレーム	銀メッキリードフレーム	銀メッキリードフレーム	銀メッキリードフレーム	銅メッキリードフレーム																																															
モールドコンパウンド	CK5000A	EDALE ELER-8-100HFE	CK5000A	EDALE ELER-8-100HFE	ハンゲル GR640 HV L1																																															
ケース外形	419AD	419AD	419AD	419AD	419B-02																																															
BGBM 拠点	オン富川(韓国)	フェニテック(日本)	オン富川(韓国)	フェニテック(日本)	オン新潟(日本)																																															
バックメタルの種類	チタン、ニッケル、銀、スズのバックメタル	金のバックメタル	チタン、ニッケル、銀、スズのバックメタル	金のバックメタル	金のバックメタル																																															
	変更前	変更後																																																		
製品表示変更	Ex-FCS フォーマット	オン・セミコンダクター フォーマット																																																		



## 認定計画:

テスト	仕様	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated BV	1008 hours
HTGB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated Vgss	1008 hours
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hours
PC	J-STD-020 / JESD-A113	MSL 1 @260°C	
IOL + PC	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C ON/OFF = 2 min	15,000 cycles
TC + PC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cycles
H3TRB + PC	JESD22-A101	Ta=85°C, 85% RH, 80% max rated BV	1008 hours
uHAST + PC	JESD22-A118	Ta=130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hours
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

認定完了予定日: 4 January 2019

## 影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
FDG311N	
FDG312P	
FDG315N	
FDG316P	
FDG327N	
FDG327NZ	
FDG328P	
FDG6301N	
FDG6303N	
FDG6304P	
FDG6306P	
FDG6308P	
FDG6316P	
FDG6317NZ	
FDG6318PZ	
FDG6320C	
FDG6321C	
FDG6322C	
FDG6332C	
FDG6335N	
2N7002DW	
2N7002DW_G	
	FDG316P, FDG328P, FDG6304P
	2N7002DW_G